

大規模パワー半導体設計を含む)

2. 材料 (先端パッケージング材料、グリーン・トランスフォーメーション (GX)
対応パワー半導体材料、次世代製造コンポーネント部材を含む)
3. 支援技術 (電子設計自動化(EDA)、評価・解析技術を含む)
4. 製造 (現世代および成熟ノード半導体の製造技術を含む)

●公募説明会

本公募の周知・促進に向け、JST 事務局による公募説明会を2月に開催予定です。
参加登録は、公募ウェブページより参加登録フォームにアクセスください。

●研究提案募集に関する問合せ先

国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST)
国際部 先端国際共同研究推進室 ASEAN 連携グループ
E-mail : joint-call-ja@jst.go.jp

当メールニュースではイベントのお知らせや公募情報等、
産学連携に関する情報をお流しいたします。
会員の皆様への情報の配信をご希望の方は、
産学連携学会事務局 (j-sangaku@j-sip.org) までご連絡ください。